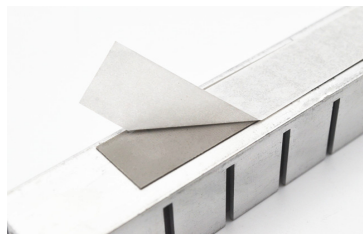


TIC® 800T 是一款采用独特晶粒定向结构的超高导热相变化材料。该结构通过微观有序排布，实现了热流路径的定向优化，从而显著倍增宏观导热效率。当温度突破50℃相变点时，材料能自动软化并浸润界面，充分填充微观不规则缝隙，最终在接触面形成热阻极低的热传导通道，提升散热系统效能。



特性

- 》优异的热导率
- 》工艺兼容性良好
- 》表面柔软，自带粘性
- 》低稳态热阻

应用

- 》功率转换设备
- 》载荷处理器
- 》服务器CPU
- 》游戏显卡GPU芯片散热

TIC® 800T 系列特性表			
产品名称	TIC® 808T	TIC® 810T	测试方法
颜色	灰色		目视
厚度 (inch/mm)	0.008 0.20	0.010 0.25	ASTM D374
密度 (g/cm ³)	2.8		ASTM D792
建议使用温度范围 (°C)	-40 ~ 125		-
相变温度 (°C)	50~60		-
导热系数 (W/m·K)	9.6		ASTM D5470
热阻抗 (°C·in ² /W) @10psi	0.018	0.019	ASTM D5470
热阻抗 (°C·in ² /W) @50psi	0.013	0.014	ASTM D5470

产品规格

标准厚度: 0.008" (0.20 mm) , 0.010" (0.25 mm)
标准尺寸: 10" × 16" (254 mm × 406 mm)

TIC®系列可模切成不同形状提供。如需不同厚度或想了解更多导热材料的产品信息，请与本公司联系。

全球方案: 在地服务
中国: +86-769-38801208
台湾: +886-2-2277-1007
加拿大: +001-604-2998559
越南: +84-396852859

service@ziitek.com
www.ziitek.com

Ziitek Technology Ltd(兆科科技有限公司)及其代理商提供的信息被认为是准确和可靠的，产品规格可能因技术改动或优化而调整，恕不另行通知。产品的使用和应用责任由最终用户承担，Ziitek(兆科)本公司不对产品的适用性，可销售性或特定用途作任何保证，亦不承担任何附带或间接损害的责任。Ziitek(兆科)及其标志为公司或关联公司所有。

